



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209862484 U

(45)授权公告日 2019.12.31

(21)申请号 201821772472.9

(22)申请日 2018.10.30

(73)专利权人 广州艾科新材料股份有限公司

地址 510760 广东省广州市经济技术开发区
骏功路18号

(72)发明人 李红领 黄庭光 廖志勇

(74)专利代理机构 长沙市融智专利事务所(普
通合伙) 43114

代理人 王英

(51)Int.Cl.

A43B 17/02(2006.01)

A43B 17/08(2006.01)

A43B 17/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种气垫型聚氨酯增高鞋垫

(57)摘要

本实用新型提供一种气垫型聚氨酯增高鞋垫,包括采用聚氨酯制成的主体,其特征在于:所述主体顶表面具有与足底曲线相吻合的曲面结构,主体的后跟部嵌入设置有增高气垫和支撑弹柱,所述增高气垫呈环形结构环绕在支撑弹柱外周。本实用新型为全脚型的增高鞋垫,通过在鞋垫后跟部设置了增高气垫和支撑弹柱,有效增强了鞋垫的回弹舒适感。



1. 一种气垫型聚氨酯增高鞋垫,包括采用聚氨酯制成的主体,其特征在于:所述主体顶表面具有与足底曲线相吻合的曲面结构,主体的后跟部嵌入设置有增高气垫和支撑弹柱,所述增高气垫呈环形结构环绕在支撑弹柱外周。

2. 根据权利要求1所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫,其特征在于:所述后跟部设置有向上曲翘的包边。

3. 根据权利要求1所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫,其特征在于:所述主体的前掌部设置为扁平状结构且设置有多透气通孔。

4. 根据权利要求1-3任意一项所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫,其特征在于:所述主体的前掌部上设置有裁剪条纹。

5. 根据权利要求4所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫,其特征在于:所述裁剪条纹由多段压印凹纹间隔连接组成。

一种气垫型聚氨酯增高鞋垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及聚氨酯制品技术领域,尤其是一种气垫型聚氨酯增高鞋垫。

背景技术

[0002] 目前市场上的增高鞋垫多数为半垫型,目的是为了增加后跟部的高度达到增高的目的,半垫型的增高设计使人体严重前倾,半垫型增高鞋垫与原鞋垫的连接度较差,往往造成在足弓部腾空没有支撑,影响身体健康,此外现有技术中的增高鞋垫仅关注高度的增加,而忽略了足底的舒适感,增高后的鞋垫变得笨重且透气性变差,容易造成行走的疲倦感。

[0003] 聚氨酯具有密度低、质地柔软、弹性好、穿起来舒适轻便、优异的耐磨性能、耐挠曲性能、硬度高、优异的减震性能、防滑性能、耐塌陷等优点,用于增高鞋垫将使增高鞋垫达到减重的效果。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供一种气垫型聚氨酯增高鞋垫。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型通过下述技术方案予以实现:一种气垫型聚氨酯增高鞋垫,包括采用聚氨酯制成的主体,其特征在于:所述主体顶表面具有与足底曲线相吻合的曲面结构,主体的后跟部嵌入设置有增高气垫和支撑弹柱,所述增高气垫呈环形结构环绕在支撑弹柱外周。

[0006] 所述后跟部设置有向上曲翘的包边。

[0007] 所述主体的前掌部设置为扁平状结构且设置有多组透气通孔。

[0008] 所述主体的前掌部上设置有裁剪条纹。

[0009] 所述裁剪条纹由多段压印凹纹间隔连接组成。

[0010] 本实用新型的有益效果为:

[0011] 本实用新型为全脚型的增高鞋垫,采用密度低、质地柔软、弹性好的聚氨酯作为鞋垫的主体,能够有效减轻鞋垫重量,并在鞋垫主体后跟部设置有增高气垫和支撑弹柱,既能起到良好的增高作用又能有效增强后跟部的回弹力度,提高鞋垫的舒适感;同时本实用新型还设置的向上曲翘的包边以及多组透气通孔均能有效增强鞋垫的透气性、舒适感;此外,本实用新型还设置有易于裁剪的裁剪条纹,可以根据具体的需求修改鞋垫的大小,适用性强。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的侧视图;

[0013] 图2是本实用新型的增高气垫和支撑弹柱配合的附视图;

[0014] 其中,1-主体、2-增高气垫、3-支撑弹柱。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明：

[0016] 如图1和图2所示，

[0017] 一种气垫型聚氨酯增高鞋垫，包括采用聚氨酯制成的主体1，其特征在于：所述主体1顶表面具有与足底曲线相吻合的曲面结构，主体1的后跟部嵌入设置有增高气垫1和支撑弹柱3，所述增高气垫1呈环形结构环绕在支撑弹柱3外周。

[0018] 所述后跟部设置有向上曲翘的包边。

[0019] 所述主体1的前掌部设置为扁平状结构且设置有多多个透气通孔。

[0020] 所述主体1的前掌部上设置有裁剪条纹。

[0021] 所述裁剪条纹由多段压印凹纹间隔连接组成。

[0022] 本实用新型为全脚型的增高鞋垫，采用密度低、质地柔软、弹性好的聚氨酯作为鞋垫的主体1，能够有效减轻鞋垫重量，并在鞋垫主体1后跟部设置有增高气垫1和支撑弹柱3，既能起到良好的增高作用又能有效增强后跟部的回弹力度，提高鞋垫的舒适感；增高气垫1环扣在支撑弹柱3外，能够很好的固定增高气垫1同时位于后跟部中心的支撑弹柱3对后跟起到主要的支撑和回弹作用，增高气垫1起到缓冲回弹作用，两者相互配合增强鞋垫的回弹舒适感；后跟部设置的向上曲翘的包边，增加鞋垫与足底的配合面，增强鞋垫的舒适感，前掌部设置的多个透气通孔均能有效增强鞋垫的透气性，此外，本实用新型还设置有易于裁剪的裁剪条纹，可以根据具体的需求修改鞋垫的大小，适用性强。

[0023] 上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理和最佳实施例，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

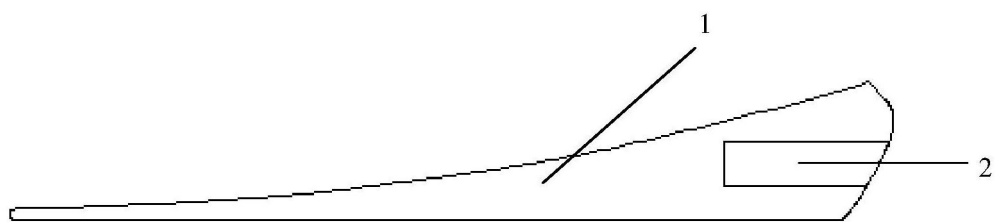


图1

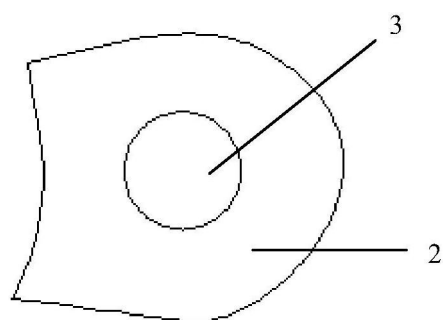


图2